# 放電プラズマ焼結(SPS)法による高強度 TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系

複合セラミックスの作製とその機械的特性

堀口勝三\*1·森山実\*2

# Manufacturing and mechanical properties of TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C composite ceramics by spark plasma sintering

# HORIGUCHI Katsumi snd MORIYAMA Minoru

 $TiB_2$ - $B_4C$  ceramic composites containing 0 up to 100 mol% $B_4C$  (20mol%steps) were fabricated from a mixture of  $TiB_2$  and  $B_4C$  powders by Spark Plasma Sintering(SPS) method.

The derived TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C composite containing  $40 \sim 60 \text{ mol}\%B_4$ C had high properties: a relative density of 95.9 $\sim$ 97.2%, Vickers hardness of  $30.2 \sim 30.4$  GPa, flexural strength of  $737 \sim 770$  MPa, fracture toughness ( $K_{IC}$ ) of  $4.99 \sim 5.99$  MPa $\cdot$ m<sup>1/2</sup>, Young's modulus of  $459 \sim 480$  GPa, and electrical conductivity of  $0.253 \sim 1.32$  MS/m. The composites present high mechanical properties compared with those for TiB<sub>2</sub> or B<sub>4</sub>C single phase. Thus, the composites are suitable as ceramic mold materials machinable by electric discharge.

キーワード: SPS, TiB<sub>2</sub>, B<sub>4</sub>C, mechanical property

## 1. 緒 言

著者らは,放電加工可能なオールセラミックス製金 型素材の開発を目的として,TiN,TiB<sub>2</sub>,ZrB<sub>2</sub>,B<sub>4</sub>C などを主体とした高強度,高導電性,高耐熱性複合セ ラミックスの研究をこれまで重ねてきた<sup>1)~8)</sup>.セラミ ックスを金型素材として利用する場合,硬度,曲げ強 度,破壊靭性値などの機械的特性が高いこと,加工上, 特に放電加工機を用いて高能率な加工を行う必要性 があることから適度な導電性があること,その他,耐 熱性・耐食性が高いこと,研磨面の表面粗さの小さい ことなどを備えていることが望まれる.

TiB<sub>2</sub>の高強度・高導電性  $^{9,10}$ と  $B_4C$  の高硬度性  $^{11),120}$ を複合させた TiB<sub>2</sub>- $B_4C$  複合体  $^{13)\sim170}$ は, セラミ  $^{9}$ クス系金型素材として有望と推測され, 著者らは, 既に TiB<sub>2</sub>から  $B_4C$  まで 20mol%ステップで変化させた TiB<sub>2</sub>- $B_4C$  系複合セラミックスを, Ar 雰囲気中, 温

度 1950°C,時間 60min, プレス圧 31.2MPa の条件 でホットプレス(以下,HP と略記する)焼結し,得ら れた焼結体の機械的及び電気的特性が組成によりど の様に変化するかを評価した<sup>7)</sup>. その結果,B<sub>4</sub>C を 20 ~60mol%含む TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 複合体は,焼結助剤無添加 で相対密度 97.4~98.9%まで緻密化を図ることがで き,ビッカース硬度 23.8~27.2GPa,ヤング率 490~ 568GPa,3 点曲げ強度 589~705MPa,破壊靱性 (*K*<sub>IC</sub>)6.46~8.05MPa・m<sup>1/2</sup>,平均表面粗さ 25.6~ 30.5nmRa,電気伝導度 0.30~3.96MS/m などの特性 を示し,高い機械的強度と導電性を有する金型素材と して極めて有望であることが分かった.

一方, 圧粉体に直接パルス状の電気エネルギーを供 給して粉体粒子間に放電プラズマを発生させ, その高 エネルギーを利用して焼結を高能率に短時間で行え る放電プラズマ焼結<sup>18),19)</sup>(以下, SPS と略記する)プ ロセスが近年開発された. 粉体内部からの自己発熱作 用となるため, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>20)</sup>, ZrO<sub>2</sub><sup>21)</sup>, SiC<sup>22),23)</sup>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub><sup>24)</sup> などの構造セラミックスが, 常圧焼結法や HP 法と比 較して 200~500℃程度低い温度で, 10~40 分程度

<sup>\*1</sup> 工学科機械ロボティックス系教授

<sup>\*2</sup> 長野工業高等専門学校名誉教授

原稿受付 2023年5月19日

	含有量	mol%	ol% 含有量 mass%		粉末量 計 150g		複合体理	1回の	焼結体
試料名*1	$TiB_2$	$B_4C$	$TiB_2$	$B_4C$	$TiB_2$	$B_4C$	論密度*2	粉末充填	作製数*3
	[mol%]	[mol%]	[mass%]	[mass%]	[g]	[g]	[kg/m <sup>3</sup> ]	量[g]	[個]
$B_4C-0$	100	0	100	0	150.0	0	4530.0	24.004	2
B <sub>4</sub> C-20	80	20	83.421	16.579	125.131	24.869	3999.7	21.194	2
$B_4C-40$	60	40	65.360	34.640	98.040	51.960	3547.3	18.797	2
$B_4C-60$	40	60	45.611	54.389	68.416	81.584	3156.8	16.728	2
$B_4C-80$	20	80	23.924	76.076	35.886	114.114	2816.4	14.924	2
$B_4C-100$	0	100	0	100	0	150.0	2517.0	13.338	2

表1 試料名,成分含有量,粉末量,複合体理論密度,粉末充填量,作製数

\*1:SPS 焼結は,真空中,焼結温度約 1680-1750℃で 12 分間,圧力 40MPa(SPS プレス全圧 28.28kN(2884kgf)である. \*2:複合体理論密度の計算においては,TiB₂の密度を 4530kgm<sup>-3</sup>(X 線密度),B₄C の密度を 2517kgm<sup>-3</sup>として算出した.

\*3:SPS 焼成後の試料形状は、φ30×7.5mm(相対密度 100%の場合)、体積 5299mm<sup>3</sup>である.

表2 TiB2原料粉末の組成(mol%)及び平均粒径(µm)

Ti	В	С	Ν	0	Fe	平均粒径
31.71	65.88	0.49	0.60	1.27	0.05	1.59

表3 B<sub>4</sub>C 原料粉末の組成(mol%)及び平均粒径(µm)

В	С	Fe	平均粒径
80.56	19.42	0.02	1.20

の昇温・保持時間で能率よく焼結が進み,その工業的 重要性も増している.

本実験では、HP法の場合と同じく、B<sub>4</sub>Cを0から 100mol%まで 20mol%ステップで組成を変化させた TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系複合体を温度 1680-1750℃,時間 12min, プレス圧力 40.0MPa の条件で SPS 焼結した.得られ た焼結体の機械的及び電気的特性を評価し、放電加工 可能な型素材として有用と判断される組成範囲を検 討した.併せて HP 法との特性上の比較や SPS 法の 有用性を検討した.以下にその詳細を報告する.

## 2.実験

#### 2-1 試料の作製

表1に、本実験のSPS法で作製した試料の名称, 成分含有量,粉末量,複合体理論密度,粉末充填量, 作製数の一覧を示す.また,表2および表3に,本研 究で用いたTiB2及びB4C原料粉末それぞれの組成と 平均粒径を示す.TiB2粉末(日本新金属㈱製TiB2-NF) はB/Ti原子比2.08,B4C粉末(出光マテリアル㈱製T グレード)はB/C原子比4.15の化学量論組成に近い 粉末を用いた.

B<sub>4</sub>C 含有量が 0~100mol%まで 20mol%ずつ変化 させた TiB<sub>2</sub>, B<sub>4</sub>C 混合粉末にエタノールを添加し, ナイロン製ボールミルを用いて 24h間混合し, スラ リーを作製した. このとき, 焼結助剤とバインダーは 無添加とした. スラリーを自然乾燥後, 乳鉢で直径 50 ~100µm程度に粉砕し, 顆粒を作製した. 顆粒を内径 30mmの黒鉛型に詰め, 真空中 1680-1750℃で 12min 間, プレス圧 40.0MPa で SPS 焼結(住友石炭鉱業製



図1 放電プラズマ焼結(SPS)装置の原理図

表4 SPS 焼結時の温度,型圧力設定パターン

	時間	温度	プレス圧	
ハターン番号.	[min]	[°C]	[MPa]	
0	0	0	40	
1	6	600	40	
2	16	1550	40	
3	18	1650	40	
4	19	1680	40	
5	20	1700	40	
6	22	1720	40	
7	24	1730	40	
8	27	1740	40	
9	31	1750	40	
10	パワーオフ			



図2 SPS 焼結のパターン図(温度と型圧力の時間変化)

SPS・2050型)を行い, 直径約 30mm厚さ約 7.5mmの 円盤状焼結体を得た. 図 1 に SPS 焼結装置模式図, 表4及び図 2 に, 焼結における温度,時間, プレス圧 の詳細を示す.室温でプレス圧を加えたまま試料の加 熱を開始して焼結を行い, 加熱停止と同時にプレス圧 をゆっくり除き, その後は自然放冷させた.なお, SPS 焼結温度と時間は, 最高温度での保持時間が少ないた め, 目安として 1680-1750℃, 12min と記載した. 試 料は, 各組成につき 2 個づつ作製した.

作製した焼結体からダイヤモンドカッターを用い て、約4×3×22mmの曲げ試験片と約10×7.5×15mm のヤング率測定用試験片を切出した.表面研磨は、試 験片表面を平均粒径約9µmのダイヤモンドスラリー によりラッピングし、その後平均粒径約3µm、次い で1µmのスラリーによるポリッシングを行い、平滑 面を得た.

以上,測定したサンプル数は,格子定数測定を除き 6~10点であり,データの代表値とばらつきは,平均 値と標準偏差で表した.

この他,上記特性評価用試料とは別に,SPS 焼結に 伴う温度-収縮変位の関係を調べるため,同じ原料粉 末,混合及び焼結条件を用いて,SPS 焼結(住友石炭 鉱業製 SPS-3.20S型)を行い,直径約50mm,厚さ約 7.7mmとなる円盤状試料を作製し,収縮開始及び終 了温度などを解析した.この解析結果については,4 -2節に述べられている.

#### 2-2 特性測定

嵩密度はピクノメータ法により,50mlの比重瓶に 焼結体を入れて測定した.電子天秤を用いて,W1:空 の比重びんの質量[kg],W2:比重びんと試料の質量 [kg],W3:比重びんに試料を入れ,さらに水を満たし た質量[kg],W4:比重びんに水のみを満たした質量 [kg]を測定した.また,このときの水温も記録した. これらの測定値から(1)式を用いて密度ρを求めた.

$$\rho = \frac{(W_2 - W_1)S}{(W_4 - W_1) - (W_3 - W_2)} \quad [kg/m^3] \tag{1}$$

ここで、S は水の密度 [kg/m<sup>3</sup>] であり、測定時の 水温にから求まる.

相対密度は嵩密度/複合体理論密度で求めた.

硬度は、対面角が 136 度のダイヤモンド四角すい 圧子を用い、圧子印加荷重 *P* を 9.8N(圧子印加質量 1kgf)としてビッカース硬さを測定した. 圧痕の対角 線長さ*d*より(2)式を用いてビッカース硬さ(*H*v)を 算出した.

$$H_{\rm V} = \frac{P}{S} = \frac{1.8544P}{d^2}$$
 [Pa] (2)

ここで, Hv: ビッカース硬さ[Pa], P: 試験荷重[N],

S: 圧痕の表面積[m<sup>2</sup>], d: 圧痕の対角線の長さの平 均値[m]である.

曲げ強度(抗折強度)は, JIS R 1601 の規格に沿って 3 点曲げ強度の測定を行った.スパン長を 18.0mm と し,曲げ破断荷重を測定し,曲げ強度を(3)式より求め た. なお,試験片は幅 4mm×厚さ 3mm,試験機のク ロスヘッドの送り速度は 0.5mm/min とした.

$$\sigma_{b3} = \frac{3PL}{2wt^2} \qquad [Pa] \tag{3}$$

ここで, σ<sub>b3</sub>: 3 点曲げ強度 (抗折強度) [Pa], P: 試 験片が破断したときの最大荷重[N], L: 下部支点間距 離[m](18mm), w: 試験片の幅[m], t: 試験片の高 さ[m]である.

破壊靭性は, SENB (Single Edge Notched Beam) 法 <sup>25)</sup>を用いて応力拡大係数 K<sub>IC</sub> の値を求めた.曲げ 試験片の中央に幅 0.15mm のダイヤモンドカッター を用いて約 1mm の深さのスリット(溝)を入れ,3 点 曲げ試験を行った.抗折試験と同様に試験片が破壊し たときの最大荷重を測定し,(4)式を用いて破壊靭性 を求めた.

$$K_{IC} = \frac{3PL\sqrt{A}}{2wt^2}Y \quad \left[\operatorname{Pa}\cdot\mathrm{m}^{1/2}\right] \tag{4}$$

ここで, *K*<sub>1</sub>c:破壊靭性 [Pa・m<sup>1/2</sup>], *P*:試験片が 破壊したときの最大荷重[N], *w*:試験片の幅[m], *t*: 試験片の高さ[m], *L*:下部支点間距離[m](17.9mm), *A*:試験片のスリットの深さ[m], *Y*: *A*/*t*比率に依存 する係数(本実験条件の場合約 1.8~2.0)である

超音波法による弾性率, すなわち, ヤング率 E, 剛性率 Gおよびポアソン比 v測定は, JIS R 1602 に従い, 5MHz の超音波インパルスを用いて, 次式より算出した.

$$E = \rho \frac{3V_T^2 \cdot V_L^2 - 4V_T^4}{V_L^2 - V_T^2} \quad [Pa]$$
(5)

$$G = \rho \cdot V_T^2 \qquad [Pa] \tag{6}$$

$$\nu = 0.5 \frac{V_L^2 - 2V_T^2}{V_L^2 - V_T^2} \tag{7}$$

但し, *E*: ヤング率[Pa], *G*: 剛性率[Pa], *v*: ポアソン 比, *K*.: 縦波音速[m/s], 及び, *V*: 横波音速 [m/s], *p*嵩 密度値[kg/m<sup>3</sup>]である.音速は,縦波用振動子及び横波用振 動子より発するインパルスを用いてヤング率測定用試験 片の往復伝播時間より求め,音速の校正には音速既知の透 明石英ガラスを基準として用いた.

表面粗さは,表面研磨後,触針式表面粗さ計(ミツト ヨ製サーフテスト SV-400)を用いて,平均粗さ Ra を 測定した.

電気伝導度は,導電性の高い 0~60mol%B<sub>4</sub>C を含 む試料に対しては四端子法 <sup>26)</sup>により 0.1~1.0A の電 流を流し,次式より求めた.



図3 SPS 焼結した TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系複合セラミックスの 理論密度, 嵩密度及び相対密度特性



図4 SPS-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>Cの硬度及び3点曲げ強度特性



図5 SPS-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>Cの破壊靭性値及び表面粗さ Ra 特性

$$\sigma = \frac{l \cdot I}{S \cdot V} \quad [S/m] \tag{8}$$

ただし, 1は電圧端子間距離 [m](17.0mm), 1は電流端子 に直列に接続した直流電流計の読み[A], S は試料断面積 [m<sup>2</sup>]、Vは電圧端子間に並列に接続した直流電圧計の読み
 [V]である.)また、導電性の低い 80~100mol%B4Cの
 試料については、厚さ約 1mmの板状試料を切出し、
 銀蒸着電極(電極面積約 25mm<sup>2</sup>)を両面に付けて 2 端子法 <sup>26</sup>により測定した。

試料の組織は, 試料を砕き, 破断面を走査型電子顕微 鏡(SEM)で観察した.

結晶相と格子定数は Cu-Ka 線を用いた X 線回折装 置(管電圧 40kV,管電流 20mA)を用いて,直接焼 結体を測定した.格子定数は高角度にピークが現れる 結晶格子面を選び,TiB<sub>2</sub>相については(103)および (212)面,B<sub>4</sub>C については(205)および(220)面より測定 した.

### 3. 結 果

# 3-1 密度

図3に,真空中,温度 1680-1750℃で 12min 間, プレス圧 40.0MPa の一定条件下で SPS 焼結して得 られた TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系複合焼結体の嵩密度及び相対密度 の変化を,B<sub>4</sub>C 含有量をパラメータとして示す.嵩密 度は,TiB<sub>2</sub>組成の 4092kg/m<sup>3</sup>から B<sub>4</sub>C 組成の 2336 kg/m<sup>3</sup>までほぼ一様に低下した.相対密度は,TiB<sub>2</sub>単 体のとき 90.3%,B<sub>4</sub>C 単体のとき 92.8%と比較的低 い値であったが,複合組成においては,95.3~97.2% に向上することができた.

#### 3-2 硬度及び曲げ強度

図4に、ビッカース硬度と3点曲げ強度の組成依存 性を示す.得られた焼結体のビッカース硬度は、TiB<sub>2</sub> 組成で20.4GPa,B<sub>4</sub>C組成で22.3GPaであったが, これらの複合組成では29.0~30.4GPaとB<sub>4</sub>C含有量 に関係なく、高いほぼ一定値を示した.現在、一般に 使用されているSKD-11合金工具鋼の焼入れ・焼戻し 材の硬度7.1GPa(JISG4404)の4倍以上もあり、複 合体は、金型用セラミックス素材として十分な硬度を 有していた.

3 点曲げ強度は、B4C を 40~60mol%含む複合組成 において 737~770MPa を示し、TiB2 単独組成の 549MPa、B4C 単独組成の 395MPa と比較して、1.4 ~1.9 倍も大きく向上できた.

硬度と曲げ強度は、相対密度に比例した特性を示す ことがわかる.

### 3-3 破壊靭性値及び表面粗さ

図5に,SENB法で求めた破壊靭性値(*K*<sub>IC</sub>)と研 磨面の平均表面粗さ Ra を示す.

破壊靭性値  $K_{IC}$ は、TiB2単体組成で4.81、B4C単体組成で3.71MPa・m<sup>1/2</sup>であった。 $K_{IC}$ も複合化により向上し、B4Cを $60 \sim 80$ mol%含む組成では5.62~



図6 SPS-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>Cの音速及び弾性率特性



図7 SPS-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>Cの格子定数特性



図8 SPS-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>Cの電気伝導度及び抵抗率特性

5.99MPa・m<sup>1/2</sup>と高い値を示した.しかし,金型材料 用としては,信頼性を高める上でもう一段の向上が望 まれるところである.

焼結体表面を 1µm のダイヤモンドスラリーを用い てポリッシングした後の平均表面粗さ Ra は 20.9~ 39.1nm であり、いずれの組成においても鏡面が得られた.特に、 $B_4C \ge 20 \sim 60 \text{mol}$ %含む組成における Raは 26nm 以下で良好な特性であった.鏡面が得られることは実用上重要で、金型材として用いた場合、製品の表面品質の向上を図ることができる.

## 3-4 音速及びヤング率

図6に縦波音速,横波音速および音速から求めたヤ ング率,剛性率を示す.

縦波音速は、 $TiB_2$ 組成の 11.0km/s から  $B_4C$  組成 の 18.5km/s まで  $B_4C$  添加量とともにほぼ増加する 傾向を示した. 横波音速も 7.54 km/s から 8.83km/s まで増加する傾向を示した. 特に  $B_4C$  の多い組成側 での縦波及び横波音速が大きかった.

ヤング率は、TiB<sub>2</sub> 組成から B<sub>4</sub>C 組成までおよそ 426GPa から 549GPa まで変化し、B<sub>4</sub>C を 20mol% 含むとき最大値、80mol%含むとき最低値を示した. 剛性率も、ヤング率ほぼヤング率に比例した傾向を示 し、TiB<sub>2</sub>組成から B<sub>4</sub>C 組成までの組成変化に対して、 171GPa~232GPa の範囲にあった. 一般的に、ほと んど材料は、硬度とヤング率は比例関係にある <sup>27)</sup>が、 本組成系では、その傾向は認められなかった.

#### 3-5 格子定数

図7に、TiB<sub>2</sub>および B<sub>4</sub>C の格子定数の変化を示す. 格子定数の変化を示すにはスケール間隔が粗い図で あるが、図に示すように、B<sub>4</sub>C 含有量に無関係に、格 子定数は常にほぼ一定であった. 観察した格子定数の 最大値と最小値の差は、TiB<sub>2</sub>の a 軸で 0.000332nm, c 軸で 0.000595nm, B<sub>4</sub>C の a 軸で 0.00068nm, c 軸 で 0.00309nm であった.格子定数に変化が小さいこ とは、複合化しても互いに反応せず、原料のままの結 晶構造を維持していることを示している.

# 3-6 電気伝導度

図 8 に、電気伝導度の組成による変化を示す.電気 伝導度は、TiB<sub>2</sub>の 6.14MS/m から、B<sub>4</sub>C の 17.0S/m まで大きく低下し、B<sub>4</sub>C 含有量に反比例する傾向を示 した.金属から半導体的な電気伝導度まで、B<sub>4</sub>C の含 有量を変えることにより大きく制御できることにな る.B<sub>4</sub>C を 0~80mol%含む複合体の電気伝導度は、 放電加工が可能となる実験値 100S/m を大きく上回 るため、高能率で安定な放電加工が可能であると判断 される.

# 4.考 察

# 4-1 SEM 組織

図9に,作製した試料の破断面の走査型電子顕微鏡 (SEM)組織を示す.(a)のTiB<sub>2</sub>(B<sub>4</sub>C-0mol%)組成では, 結晶粒径が2~3µm程度の微細組織で,気孔もとこ



図9 TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系(B<sub>4</sub>C 含有量 20mol%ステップ)SPS 焼結体の破面の SEM 組織

ろどころに見られた. (b)~(e)の 20~80mol%B<sub>4</sub>C 複 合体では,白色に観察される TiB<sub>2</sub>相の粒径は(a)の場 合と殆ど同じであり,一方,灰色に観察される B<sub>4</sub>C 相 の結晶粒界が明白でないが,これらは微細な組織で均 一に混合した複合体を形成し,気孔も減少した. (f)の B<sub>4</sub>C では,破面はガラス面のように滑らかで,凹凸の ある破面は観察されなかった.しかし,気孔がかなり 存在した. SPS 焼結では,加熱時間が短いため粒成長 が生じ難く,微細な組織が得やすい傾向があり,結晶 粒が微細であれば含まれるクラックも小さく,曲げ強 度も比較的高い値が得られると予想される.

# 4-2 SPS 焼結温度と収縮変位量

図 10 に、TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系複合体(直径 50mm, SPS 焼 結後の厚さ約 7.7mm の試料)の SPS 焼成において, 焼成時間に対する実際の SPS 焼成温度及び焼結収縮 変位(X[mm])を測定した結果を示す. SPS 温度は約 5min まで約 570°Cに保持されて記録されているが, これは光高温計の温度測定範囲が低温領域で対応し ていないためで,実際は,表4に示したプログラム温 度制御パターンに沿って加熱されている.

収縮変位(X)は、焼結開始時にプレス圧が加わった 状態を基準の0mmとし、正目盛の向き(上向き)は膨



 図 10 SPS-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C の焼結時間に対する加熱温度と 焼成体厚みの膨張収縮変位 X



図11 SPS-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>Cの破壊エネルギー及びクラック長

張変位,負目盛の向き(下向き)は収縮変位を示す.加 熱に伴い変位曲線は、どの組成の試料も加熱時間が 12~13min(SPS温度約1300℃)まで膨張しているが、 これは加熱に伴う原料粉末の熱膨張で,焼結はまだ進 行していない状態と考えられる.この後、1300~ 1400℃付近から急激に焼結に伴う収縮に転じ、焼成 後の試料厚から推定して16~30%程度の収縮が生じ た.SPS 焼結時間 20min(約 1700℃)あたりでは、 TiB<sub>2</sub>(B<sub>4</sub>C 0mol%)の試料は収縮途上であるが、他の組 成の試料は高温で収縮から再び膨張に転じた.焼結が 進行中であれば膨張現象は考えにくいので、この高温 域での膨張は、焼結がほぼ完了した後の加熱による熱 膨張と考えられる.型の加圧力を除くと同時に、収縮

した変位は急激に回復方向に変化した.実験で高密度

化や高強度化が図られた B<sub>4</sub>C を 60, 80mol%を含む 試料は収縮変位が大きく,また,収縮途上にある TiB<sub>2</sub>(0mol%B<sub>4</sub>C)試料は,焼結温度や時間をやや不足 ぎみで,焼結が完了していないことを示している.

#### 4-3 破壊エネルギー及びクラック長

セラミックスの破壊に伴う破壊エネルギーyfと破壊源 となるクラック長さ 2Cは、弾性体モデル(平面歪み)の場 合、次式を用いて求めることができる<sup>20</sup>.

$$\gamma_f = \frac{K_{IC}^2 (1 - \nu^2)}{2E} \quad [J/m^2]$$
(9)  
$$2C = \frac{4E\gamma_f}{\pi\sigma_c^2 (1 - \nu^2)} \quad [m]$$
(10)

ここで,  $K_{IC}$ : 破壊靱性値[ $Pa \cdot m^{1/2}$ ], E: ヤング率[Pa], v: ポアソン比,  $\sigma_c$ : 曲げ強度[Pa]である.

図 11 に、本実験での測定値を代入し、セラミック スの破壊に伴う破壊エネルギーγfと破壊源となった クラック長さ2*C*を求めた結果を示す.

 $y_{\rm f}$ は, TiB<sub>2</sub>組成で 23.4J/m<sup>2</sup>, B<sub>4</sub>C 組成で 12.2J/m<sup>2</sup> であるのに対して, B<sub>4</sub>C を 60~80mol%含む複合組成 では 34.8~38.9J/m<sup>2</sup> と大きく向上できた. 一方, 想 定されるクラック長さは, TiB<sub>2</sub>組成で 48.8µm, B<sub>4</sub>C 組成で 56.1µm に対し, B<sub>4</sub>C を 20~40mol%含む複合 組成では 26.8~31.4µm に減少できた. クラック長さ は小さいほど強度は向上するが,結晶粒径に深く関係 していると推定され, この組成範囲では組織観察の結 果から TiB<sub>2</sub>の結晶粒が成長していないことが関係し ていると考えられる. また, SPS 法は, HP 法と比べ て急速加熱により結晶粒の成長を抑制できるため, 含 まれるクラック長も全般的に小さくできると考えら れる.

#### 4-4 HP法による試料との特性比較

表5に、本実験で作製した SPS 法による TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系焼結体と、全く同じ粉末配合条件で HP 法により作 製した焼結体の機械的及び電気的特性を比較した結 果を示す.組成は、共に B<sub>4</sub>C を 0~100mol(20mol% ステップ)変化させた系とし、また、HP 法の焼結条件 は、Ar 雰囲気中で温度 1950<sup>°</sup>C、時間 60min、プレス 圧 31.2MPa である.

表に示すように, SPS 法と HP 法とでは極端な特 性上の差は見られなかったが,異なる点を以下に列挙 した. ①SPS 法により作製した TiB<sub>2</sub>, B<sub>4</sub>C 単体組成 での相対密度はそれぞれ 90.3, 92.8%であり, HP 法 の場合と比較してそれぞれ 7.0, 6.0%も低い値であっ た. 複合組成での相対密度も若干(1%程度)低めであ った. また, SPS 法の場合は, 60mol%B<sub>4</sub>C を含む場 合に最も相対密度(97.2%)が向上したが, HP 法では, 20mol%B<sub>4</sub>C を含む場合(98.9%)であった. ②ビッカ ース硬度は、SPS 法の場合複合組成範囲でいずれも 高い一定値(約 30GPa)を示した.一方、HP 法の場合、 B<sub>4</sub>C 含有量に比例して直線的に向上した.③3 点曲げ 強度は、全体的に SPS 法が高めであった.結晶粒が 成長しなかったためと推定される.一方 K<sub>1</sub>cは、SPS 法の方が低かった.④破壊エネルギー $_{\rm F}$ 及びクラック 長 2*C*は、HP 法の 50~70%程度と共に小さめであっ た.⑤電気伝導度は、SPS 法が若干低めである.相対 密度がやや低いこと、及び、結晶粒が小さいので粒界 部での電気抵抗が大きくなるためと推定される.

SEM 組織の比較では、SPS 法による図 9(a)の TiB<sub>2</sub> 組成の場合, 微細な組織(粒径 2~3 $\mu$ m)であり, 原料 粉末からの粒成長が殆ど生じていなかったが, HP 法 <sup>7)</sup>の場合は,結晶粒(約 4 $\mu$ m以上)の成長が認められた. また, (f)の B<sub>4</sub>C 組成では, 破面は共にガラス面のよ うに滑らかであったが, 気孔については, HP の場合 には殆ど無かったのに対し, SPS 法の場合は対照的 にかなり存在していた.

**表5** TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系複合セラミックスの焼結体作製における SPS 法と HP 法の特性比較

焼結法	SPS 法(本実験)	HP 法
焼結条件(温度)	1680-1750℃	1950°C
(時間)	12min	60min
(型圧力)	40MPa	31.2MPa
組成	TiB <sub>2</sub> -B <sub>4</sub> C 系	TiB <sub>2</sub> -B <sub>4</sub> C 系
相対密度[%]	90.3-97.2	97.2-98.9
硬度[GPa]	20.4-30.4	19.9 - 36.2
曲げ強度[MPa]	395-770	400-705
破壞靭性	2 71-5 00	E 99-9 OF
$[MPa \cdot m^{1/2}]$	3.71-5.99	5.23-8.05
ヤング率[GPa]	426-549	472-591
剛性率[GPa]	171-233	198 - 265
縦波音速[km/s]	11.0-18.5	11.8-15.3
横波音速[km/s]	7.54-8.83	7.79 - 8.95
ポアソン比	0.12-0.28	0.11-0.21
表面粗さ Ra[nm]	20.9-39.1	25.6 - 35.3
破壊エネルギ[J/m <sup>2</sup> ]	12.9 - 38.5	22.8 - 58.9
クラック長[m]	26.8-56.1	70.7-142.3
電気伝導度[MS/m]	$1.70 \times 10^{-5}$	$1.30 \times 10^{-5}$
	-6.14	-8.02

#### 4-5 金型素材としての有効な組成

本実験で作製した B<sub>4</sub>C を 40~60mol%含む TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 複合体は,硬度,曲げ強度及び導電性が高く,ま た,表面粗さも小さいことから,放電加工可能な金型 素材として,極めて有望と思われる.但し,破壊靱性 がやや低いため,もう一段の工夫を行う必要がある. SPS 法は,HP 法や常圧焼結法と比較して短時間(1回 の加熱冷却全所要時間3時間程度)に能率よく焼結可 能であり,工業的にも特性的にも重要な価値を持つと 思われる.

# 5. 総 括

TiB<sub>2</sub>と B<sub>4</sub>C 粉末より TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系複合セラミック ス焼結体を, 真空中, 温度 1680-1750℃, 時間 12min, プレス圧 40.0MP の条件で放電プラズマ焼結(SPS)し, 機械的及び電気的特性を調べたところ, 次のことがわ かった.

- (1) B<sub>4</sub>C を 40~60mol%含む TiB<sub>2</sub>·B<sub>4</sub>C 複合体は、焼 結助剤無添加で相対密度 95.9~97.2%に緻密化を 図ることができ、その機械的特性は、ビッカース硬 度 30.2~30.4GPa、3 点曲げ強度 737~770MPa、 破壊靱性(*K*<sub>IC</sub>) 4.99~5.99MPa·m<sup>1/2</sup>、ヤング率 459 ~480GPa、平均表面粗さ(Ra)20.9~25.3nm を示 し、TiB<sub>2</sub>、B<sub>4</sub>C それぞれ単体組成より大幅な特性の 向上が見られた。
- (2) 上記複合体の破壊エネルギーは 25.8~38.9J/m<sup>2</sup>,
   含有するクラック長さは 26.8~42.1µmと推定された.
- (3) 上記複合体の電気伝導度は 0.253~1.32MS/m を 示し、安定に放電加工ができる材料である.
- (4) 温度 1950℃,時間 3.6ks, プレス圧 31.2MPa で 行ったホットプレス(HP)法による同じ組成系と比 較して, SPS 法による試料は極端な特性上の差異 がなかった.
- (5) SPS 法は, 短時間で緻密な焼結体が能率よく作製 でき,特性も良好で実用的である.

# 参考文献

- (1) 森山実,鎌田喜一郎、小林義一:ホットプレス法による窒化チタンセラミックスの強度及び電気的特性.日本 セラミックス協会学術論文誌, Vol.99, No.4, pp.286-291(1991.4)
- 2) 森山実,青木博夫,小林義一,鎌田喜一郎:各種焼結 助剤添加ホットプレス TiN セラミックスの機械的特性. Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.101, No.3, pp.279-284(1993.3)
- 3) 森山実,青木博夫,鎌田喜一郎:TiN-TiB2系常圧焼結 体の機械的及び電気的特性. Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.103, No.8, pp. 844-849(1995.8)
- 4) 森山実, 青木博夫: B<sub>4</sub>C と TiN 粉末の反応による TiB<sub>2</sub>-TiN<sub>x</sub>C<sub>y</sub> 複合焼結体の作製とその機械的特性. Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.104, No.4, pp.333-339(1996.4)
- 5) 森山実, 青木博夫, 小林義一: TiN と B<sub>4</sub>C 粉末の固相 反応を利用したホットプレス法による高強度 TiB<sub>2</sub>-TiN<sub>x</sub>C<sub>y</sub> 複合焼結体の作製とその機械的特性. Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.106, No.8, pp.824-829(1998.8)

- 6) 森山実,青木博夫,小林義一:ホットプレス法による TiB<sub>2</sub>-ZrB<sub>2</sub>系セラミックス焼結体の作製とその機械的特 性. Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.106, No.12, pp.1196-1200(1998.12)
- 7) 森山実:ホットプレス法による高強度 TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C 系セ ラミックス焼結体の機械的及び電気的特性. Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.109, No.6, pp.550-556(2001.6)
- 8) 森山実:ジルコニア・硼化チタン系複合セラミックスの 機械的・電気的特性評価-型素材への応用における基礎 特性評価-. 財団法人金型技術振興財団金型に関する研 究発表資料, pp.11-22(2001.6)
- 9) J. Casting, P. Costa: "Boron and Refractory Borides ed. by Vlado I. Matkovich", Springer-Verlag, pp.390-412 (1977)
- Ronald G. Munro: "Material Properties of Titanium Diboride", Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, Vol.105, No.5, pp.709-720(2000.9)
- Francois Thévenot: "Boron carbide —A comprehensive review", Journal of the European Ceramic Society, Vol.6, No.4, pp.205-225(1990.4)
- 12) A.K. Suri, C. Subramanian, J.K. Sonber, T.S.R.C. Murthy: "Synthesis and consolidation of boron carbide: a review", International Materials Reviews, Vol.55, No.1, pp.4-40(2010)
- 13) Diletta Sciti, Simone Failla, Servet Turan, Umut Savaci, Pietro Galizia: "Properties and ballistic tests of strong B<sub>4</sub>C-TiB<sub>2</sub> composites densified by gas pressure sintering", Journal of the European Ceramic Society, Vol.43, No.4, pp.1334-1342 (2023.4)
- 14) S. Tuffé, J. Dubois, G. Fantozzi, G. Barbier:
  "Densification, microstructure and mechanical properties of TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C based composites", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol.14, No.5-6, pp.305-310 (1996.2)
- 15) Suzuya Yamada, Kiyoshi Hirao, Yukihiko Yamauchi, Shuzo Kanzaki: "High strength B<sub>4</sub>C– TiB<sub>2</sub> composites fabricated by reaction hotpressing", Journal of the European Ceramic Society, Vol.23, No.7, pp.1123-1130(2003.6)
- 16) Dewen Wang, Songlin Ran, Lu Shen, Huifeng Sun, Qing Huang: "Fast synthesis of B<sub>4</sub>C-TiB<sub>2</sub> composite powders by pulsed electric current heating TiC-B mixture", Journal of the European Ceramic Society, Vol.35, No.3, pp.1107-1112

(2015.3)

- 17) Wenchao Guo, Qianglong He, Aiyang Wang, Tian Tian, Chun Liu, Lanxin Hu, Weimin Wang, Hao Wang, Zhengyi Fu: "Effect of TiB<sub>2</sub> particles on microstructure and mechanical properties of B<sub>4</sub>C-TiB<sub>2</sub> ceramics prepared by hot pressing", Ceramics International, Vol.49, No.3, pp.4403-4411(2023.2)
- 18) Mamoru Omori: "Sintering, consolidation, reaction and crystal growth by the spark plasma system (SPS)", Materials Science and Engineering A Structural Materials, Vol.287, No.2, pp.183-188(2000)
- 19) 鴇田正雄: 放電プラズマ焼結(SPS)法によるセラミッ クス焼結の現状と将来性. セラミックス, Vol.49, No.2, pp.91-96(2014.2)
- 20) Zhijian Shen, Mats Johnsson, Zhe Zhao, Mats Nygren: "Processing Science - Spark Plasma Sintering of Alumina", Journal of the American Ceramic Society - Including Communications of the American Ceramic Society, Vol.85, No.8, pp.1921-1927(2002)
- 21) W. Li, L. Gao: "Rapid sintering of nanocrystalline ZrO<sub>2</sub>(3Y) by spark plasma sintering", Journal of the European Ceramic Society, Vol.20, No.14, pp.2441-2446(2000)
- 22) Z. Pan, W. Pan, R. Li: "Preparation of SiC Ceramics by Spark Plasma Sintering", Key Engineering Materials, Vol.224, pp.713-716(2002)
- 23) D. S. Perera, M. Tokita, S. Moricca<sup>;</sup>, "Comparative study of fabrication of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC composites by spark plasma sintering and hot isostatic pressing", Journal of the European Ceramic Society, Vol.18, No.4, pp.401 -404(1998)
- 24) T. Nishimura, M. Mitomo, H. Hirotsuru, M. Kawahara: "Fabrication of silicon nitride nanoceramics by spark plasma sintering", Journal of Materials Science Letters, Vol.14, No.15, pp.1046-1047(1995)
- 25) 松野外男,若井史博,岡田正見,奥田博:高強度セラ ミックスのノッチドビーム法による破壊靭性. 窯業協 会誌, Vol.90, No.5, pp.21-28(1982.5)
- 26) 中澤達夫,藤原勝幸,押田京一,服部忍,森山実:「電気・電子材料」, pp.144-148, コロナ社(2005.1)
- 27) 阿部弘, 川合実, 菅野隆志, 鈴木恵一朗:「エンジ ニアリングセラミックス」, pp.132-159, 技報堂出 版(1984.9)
- 28) 宮田昇,神野博:セラミックスの力学的性質--セ ラミックスの強度と破壊---. 材料, Vol.32, No.354, pp.340-346(1983.2)